

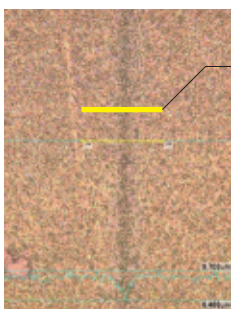
TOP DuNC CU

レベリング性に優れ、ピットが生じにくい
 装飾用硫酸銅めっき添加剤

Additive for Acid Copper Plating with High Leveling Power, Can Reduce Pit

- 素材キズの埋め込み性に優れ、美しい外観が得られる
 Can cover dent areas finely, can get beautiful appearance
- スラッジ発生量が少ない
 Reduce sludge amount
- ピットを生じにくい
 Can reduce pit
- 浴管理が容易
 Easy bath control

優れたレベリング性 Excellent leveling power



深さプロファイル測定箇所
 Depth profile measuring spot

Rz : 2.518 μ m (最大深さ)
 (Maximum depth)

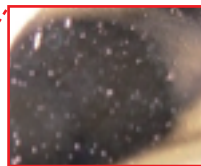
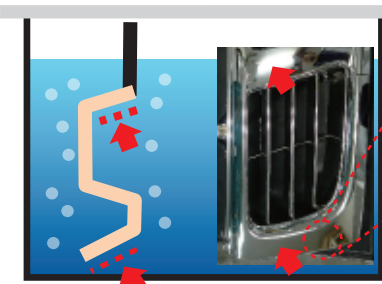
硫酸銅めっき
 Acid copper plating



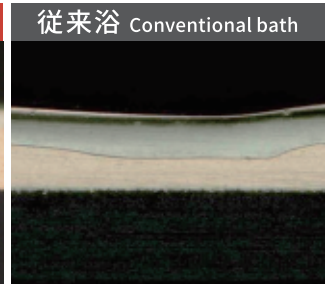
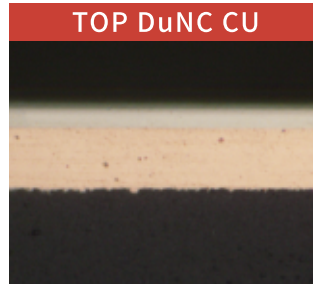
ABS成形品のウェルド部デプスプロファイル(エッチング18分)
 Molded ABS resin, weld-part depth profile (Etching: 18min)

素材キズをレベリングし、美しい外観を実現
 Can cover dent part finely, can get beautiful appearance

ピットを生じにくい Prevent pit



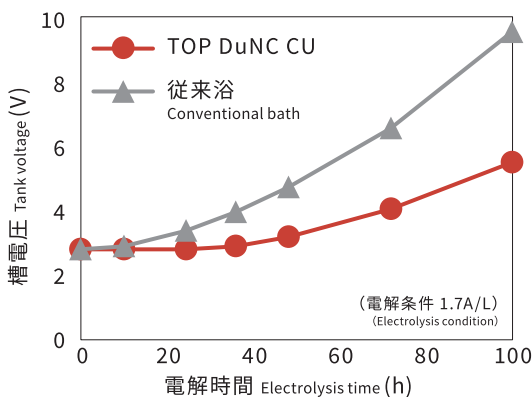
従来品:
 ピットを生じやすい
 Conventional bath:
 cause pit easily



----- エア攪拌が弱く、電流密度が高くなる
 Weak air agitation, high current density

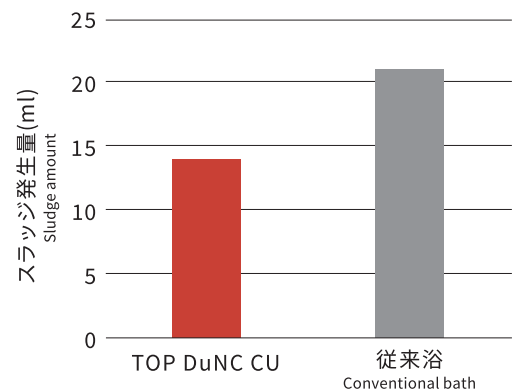
ピットを防ぎ、外観が向上
 Prevent pit, improve appearance

槽電圧の上昇を抑え、スラッジの発生を抑制する Can stop tank voltage increase, prevent sludge occurrence



電解にともなう槽電圧の変化
 Tank voltage change by electrolysis

100時間後の
 スラッジ発生量を
 メスシリンダーで測定
 Measure sludge amount
 after 100hour test



スラッジ発生量の比較
 Comparison of sludge amount